

CEI 60749-22
(Première édition – 2002)

DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS –
MÉTHODES D'ESSAIS MÉCANIQUES
ET CLIMATIQUES –

Partie 22: Robustesse des contacts soudés

IEC 60749-22
(First edition – 2002)

SEMICONDUCTOR DEVICES –
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS –

Part 22: Bond strength

CORRIGENDUM 1

Page 6

Au lieu de:

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2012.

lire:

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007.

Page 7

Instead of:

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2012.

read:

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2007.

iteh.com
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

[IEC 60749-22:2002/COR1:2003](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/db138711-736c-42ec-814e-dfbf879c989a/iec-60749-22-2002-cor1-2003)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/db138711-736c-42ec-814e-dfbf879c989a/iec-60749-22-2002-cor1-2003>